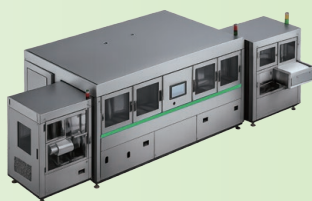


Wafer

Die / Chip

## NATS®-1302 / 1303



## KGD AC/DC Test System

NATS-1302 : DC/AC Test  
Multiple Temp Control ~200°C  
3 Stage + Liner Handler Type  
UPH 1000 chips

NATS-1303 : DC/AC Test  
Multiple Temp Control ~200°C  
4 Stage + Index Handler Type  
UPH 2000 chips

ウェハーからダイ、チップレベルに対応する  
各種ハンドラーを取り揃え、高スループット  
Applied to Wafer / Die / Chip level and high-through put

DBC / AMB

## NATS®-1202



## DBC/AMB Test System

最大3000A / 1500V

ワイヤボンディング前後のDBCおよびAMBの静的/動的機能検査に対応  
Static and dynamic functionality tester for DBC and AMB before/after wire bonding

AQG324 試験規格 Silicon Carbide FET 対応機種 | AQG324 test standard Silicon carbide FET compatible model

## NATS®-8151 / 8152



Module

## Dynamic HTRB HTGB Tester

高温逆バイアス DHTRB / 高温ゲートバイアス DHTGB

広い周波数範囲と柔軟なパラメータ設定に対応するAC/DCテストが可能  
Wide range frequency / Flexible setting AC/DC test available

## NATS®-8153



## Dynamic H3TRB Tester

高温高湿逆バイアス Dyn H<sup>3</sup>TRB

複数レイヤーを個別 / 同時実行を可能とし最小動作単位は1レイヤーから設定可能  
Individual / simultaneous execution setting of multiple layers,  
and the Minimum operation unit can be set from 1 layer

## NATS®-8140



## Continuous Power Characterizer

連続出力特性検査 | Continuous Power Characterize

CMTI : Max200kV/μs  
Output Phase Current : 800Arms  
Frequency : 1000Hz